

東京応化工業株式会社 決算説明資料

-2014年3月期第2四半期決算-

2013年11月6日

目次

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1.2014年3月期第2四半期連結決算 | p.2 |
| 2.2014年3月期通期連結決算予想 | p.12 |
| 3.トピックス
～tok中期計画2015の取組み～ | p.19 |

**2014年3月期第2四半期
連結決算**

業績概要

(百万円、%)

	2012/9	2013/9		
			増減	増減率
売上高	36,654	39,071	+2,417	+6.6
営業利益	4,271	5,047	+775	+18.2
経常利益	4,418	5,767	+1,348	+30.5
当期純利益	2,841	3,725	+884	+31.1

- 期中平均為替 (USD/円) : 78.5円/ドル (2012/9) ⇒ 97.9円/ドル (2013/9)
- 売上高 : 装置事業の減収を、材料事業の増収で補い、前年比6.6%の増収。当社予想 (2013.5.8公表) を上回った。
- 営業利益 : 材料事業の大幅増益により、前年比18.2%の増益。
- 経常利益 : 営業増益に為替差益等が加わり、前年比30.5%の増益。

営業外損益・特別損益

(百万円)

	2012/9	2013/9	前年比
営業外損益	147	719	+572
(営業外収益)	(314)	(914)	+600
受取利息・配当金	126	192	+65
為替差益	—	302	+302
持分法による投資利益	78	99	+20
(営業外費用)	(166)	(194)	+27
為替差損	36	—	△36
租税公課	102	154	+52
特別損益	△300	△225	+75
(特別利益)	(2)	(0)	△1
固定資産売却益	2	0	△1
(特別損失)	(303)	(225)	△77
減損損失	—	214	+214
投資有価証券評価損	286	—	△286

事業別セグメントの業績

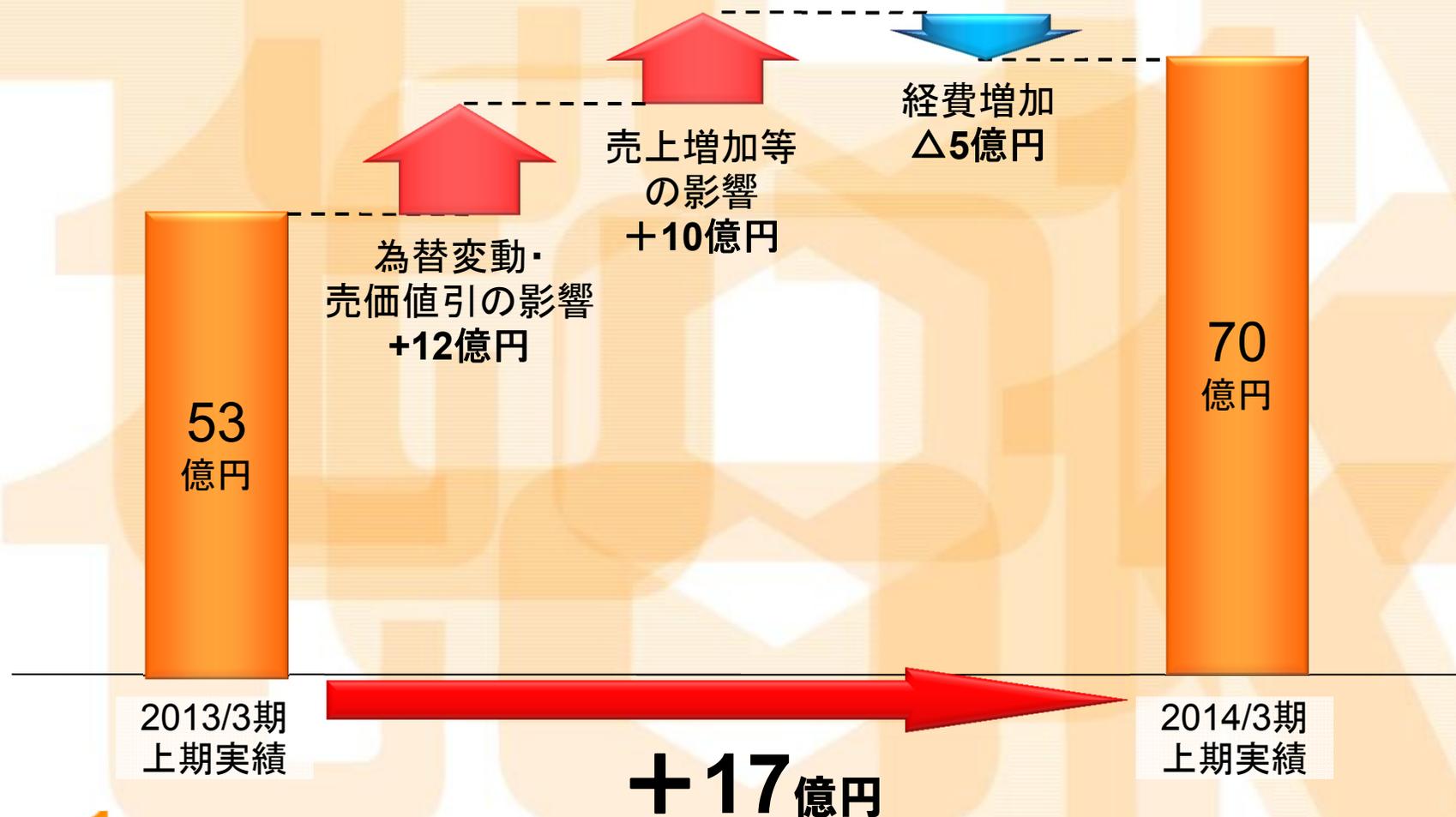
(百万円、%)

	2012/9	2013/9	
		増減	増減率
売上高	36,654	39,071	+2,417 +6.6
材料事業	33,742	37,543	+3,801 +11.3
エレクトロニクス機能材料	21,813	23,091	+1,277 +5.9
高純度化学薬品	11,689	14,283	+2,594 +22.2
その他	239	168	△70 △29.6
装置事業	2,912	1,527	△1,384 △47.5
営業利益	4,271	5,047	+775 +18.2
材料事業	5,325	7,045	+1,720 +32.3
装置事業	431	△472	△904 -
消去又は全社	△1,485	△1,525	△39 -

(注) 装置事業の売上は消去後の数字。

営業利益の増減内訳（材料事業）

2013年3月期上期実績 対 2014年3月期上期実績

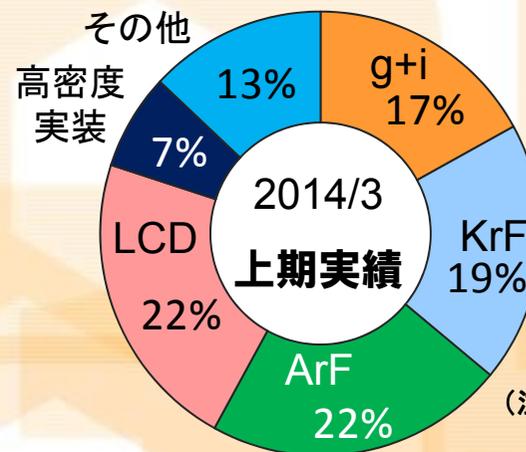
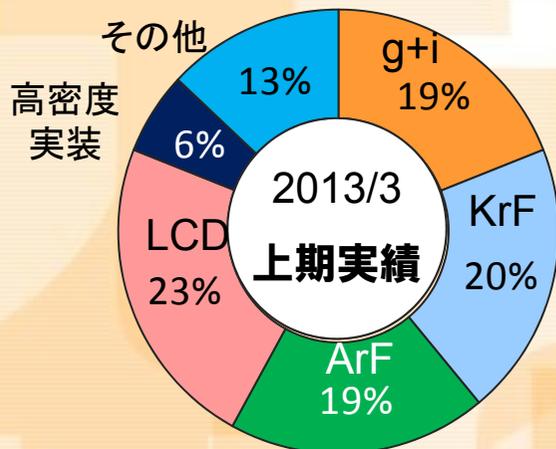


材料事業の売上内訳



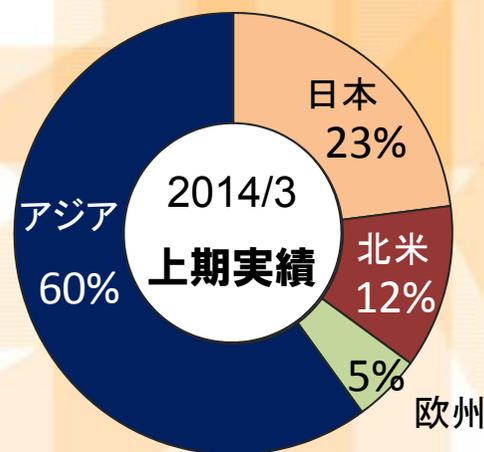
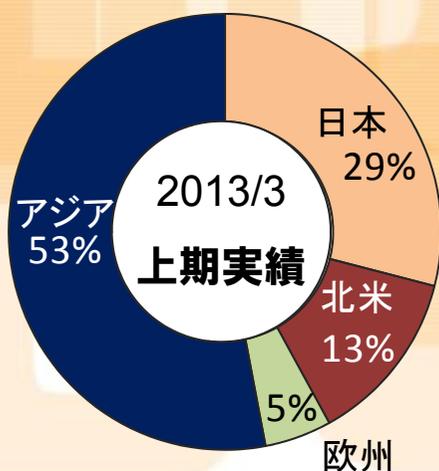
(ご参考) エレクトロニクス機能材料部門

エレクトロニクス機能材料の種類別売上構成



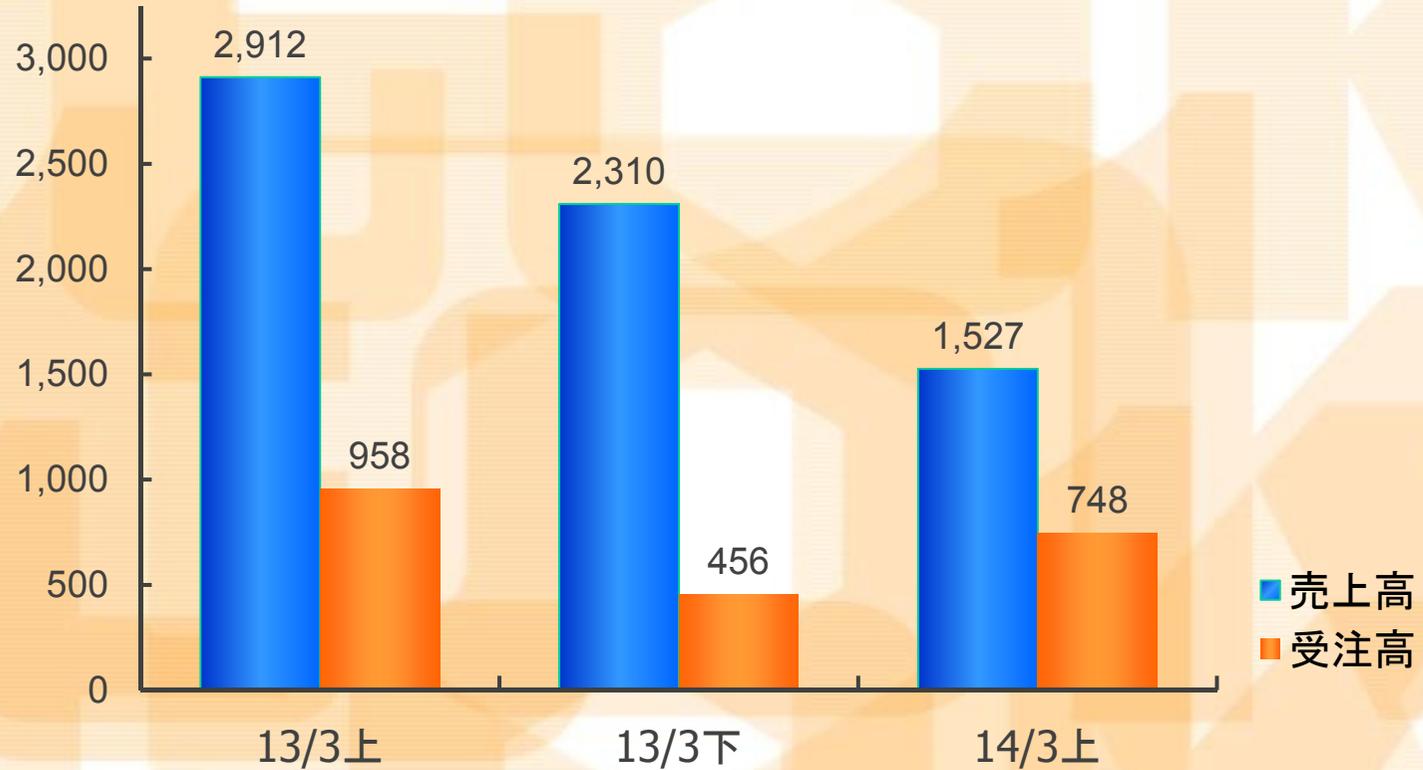
(注) 高密度実装:レジスト材料、MEMS材料、WHS材料

半導体フォトレジストの地域別売上構成



装置事業

売上高・受注高
(百万円)



(百万円)	13/3上	13/3下	14/3上
期末受注残高	3,401	1,547	769

比較貸借対照表

(百万円)

	2013/9	13/3末比	
流動資産	85,187	△1,671	
現金預金	55,245	△1,825	
売上債権	17,873	+1,585	
たな卸資産	9,608	△890	
有形固定資産	36,864	+5,806	建物及び構築物 +47 機械装置 △87 工具器具備品 +235 建設仮勘定 +5,759
無形固定資産	506	+168	
投資その他の資産	27,942	+532	
流動負債	14,734	△279	
買入債務	6,892	+999	
固定負債	2,588	△223	利益剰余金 +2,643 自己株式 +57 為替換算調整勘定 +1,907 その他有価証券評価差額金 +547
純資産合計	133,177	+5,339	
総資産	150,501	+4,836	

キャッシュフロー

(百万円)

	2012/9	2013/9
営業キャッシュフロー	+5,930	+5,740
税金等調整前当期純利益	+4,117	+5,542
減価償却費	+1,800	+1,241
貸倒引当金の増減(△)額	△26	△802
売上債権の増(△)減額	+1,355	△993
たな卸資産の増(△)減額	+854	+1,438
仕入債務の増減(△)額	△147	+821
前受金の増減(△)額	△1,595	△823
法人税等の支払い	△618	△1,655
投資キャッシュフロー	+1,254	△6,039
財務キャッシュフロー	△1,109	△1,403
換算差額	+45	+1,057
現金及び現金同等物の増減(△)額	+6,120	△645

装置事業の検収促進

主な内訳

長期預金の純増預入 △3,000
有形固定資産の取得 △7,116
長期性預金の払戻収入 +4,500

主な内訳

配当金の支払 △1,406
(含む少数株主)

**2014年3月期通期
連結決算予想**

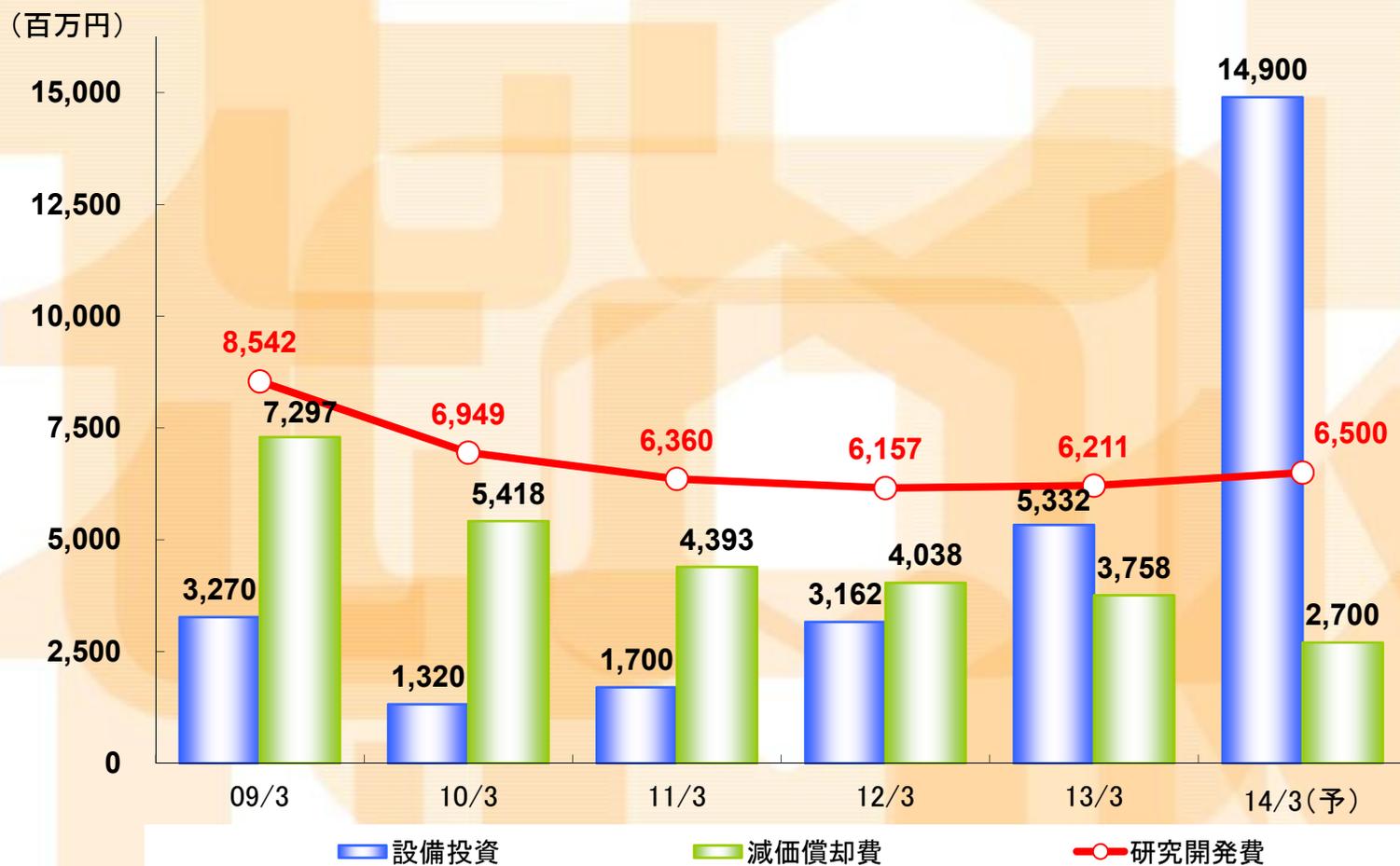
業績予想概要（通期）

（百万円、％）

	2013/3 実績	2014/3予想	
		増減	増減率
売上高	72,919	77,900	+4,980 +6.8
営業利益	7,872	9,800	+1,927 +24.5
経常利益	8,617	10,900	+2,282 +26.5
当期純利益	5,443	6,900	+1,456 +26.8

- 為替前提（USドル）：81.9円／ドル（2013/3）⇒95.0円／ドル（2014/3下期）
- 売上高：装置事業の大幅減収から、通期予想を下方修正するが、材料事業の売上増加により、前年比6.8%の増収を確保。
- 営業利益：材料事業の前年比増益は続くが、装置事業の不振により、通期予想を下方修正。前年比24.5%の増益を予想。

設備投資・減価償却・研究開発



事業別セグメント業績予想

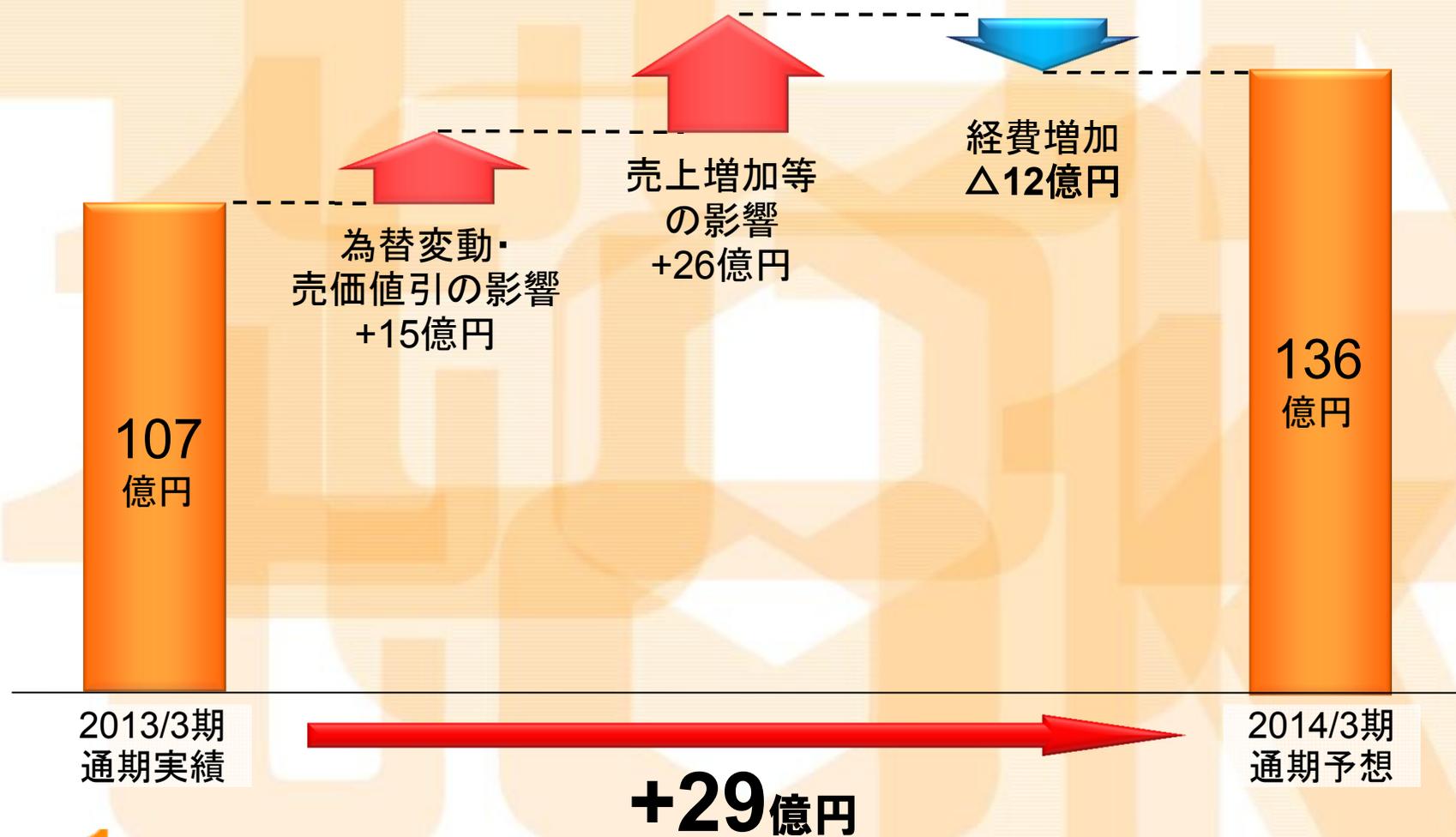
(百万円、%)

	2013/3 通期実績	2014/3通期予想		
			増減	増減率
売上高	72,919	77,900	+4,980	+6.8
材料事業	67,697	74,700	+7,002	+10.3
エレクトロニクス機能材料	43,116	46,600	+3,483	+8.1
高純度化学薬品	24,144	27,900	+3,755	+15.6
装置事業	5,222	3,200	△2,022	△38.7
営業利益	7,872	9,800	+1,927	+24.5
材料事業	10,716	13,600	+2,883	+26.9
装置事業	232	△700	△932	—
消去又は全社	△3,075	△3,100	△24	—

(注) 装置事業の売上は消去後の数字

営業利益の増減内訳（材料事業）

2013年3月期実績 対 2014年3月期予想

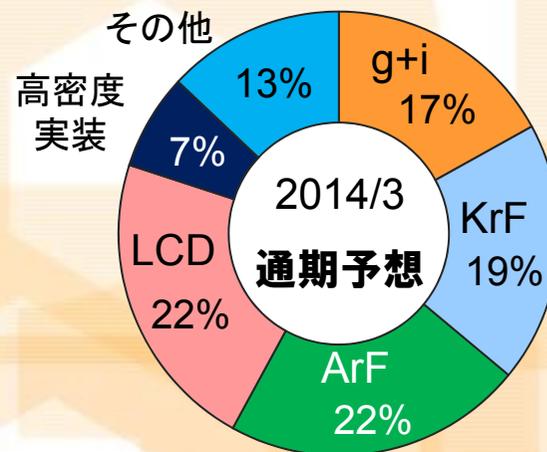
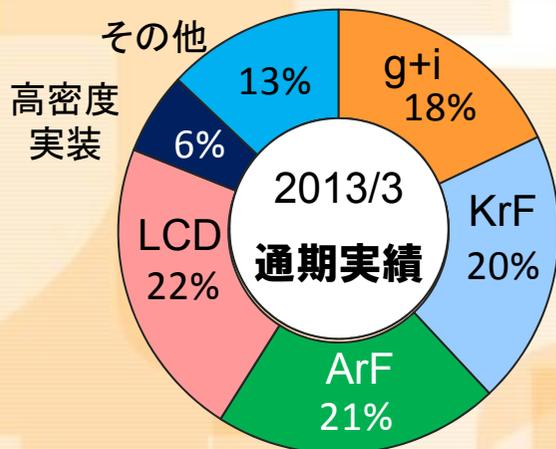


材料事業の売上内訳（予想）

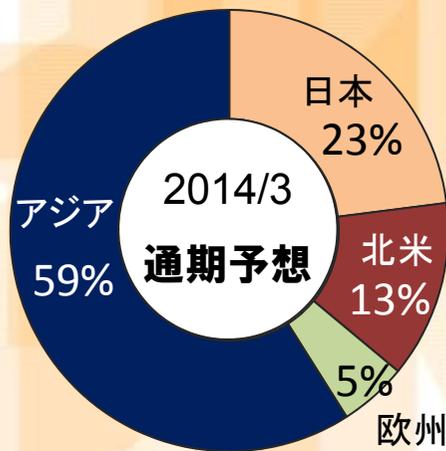
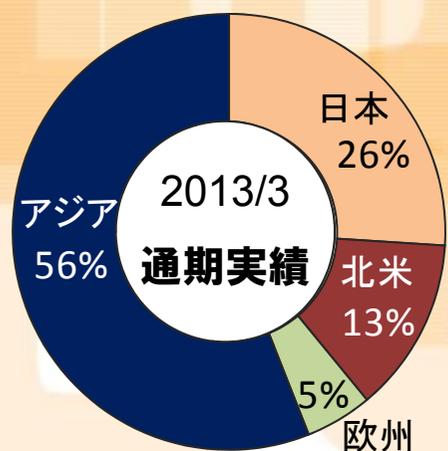


(ご参考) エレクトロニクス機能材料部門

エレクトロニクス機能材料の種類別売上構成



半導体フォトレジストの地域別売上構成





トピックス
～tok中期計画2015の取組み～

ArFの事業成長力強化

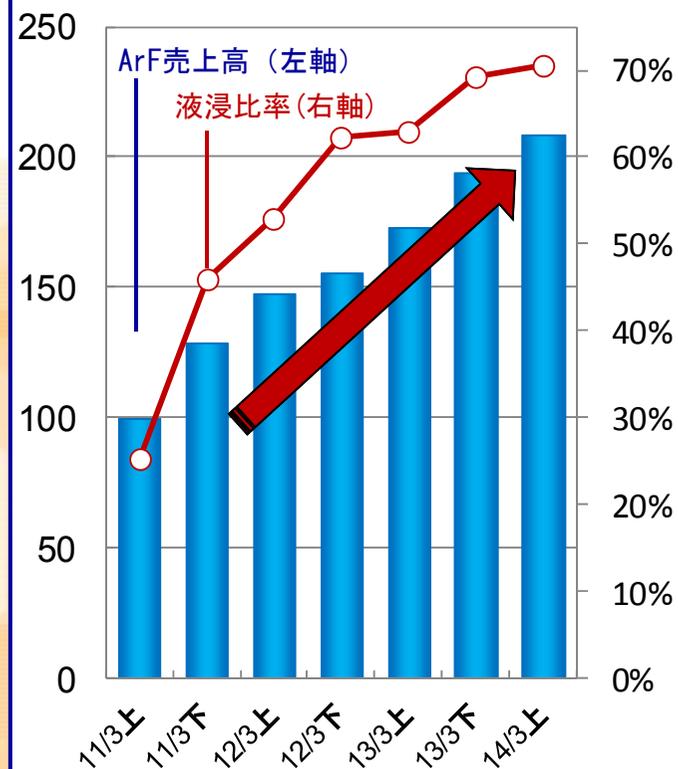
韓国・TOK先端材料株式会社の竣工

● 海外事業の拡大発展、製品の安定供給の実現

- ✓ 2013年11月下旬
生産体制確立、適時サンプル出荷の開始
- ✓ 2014年7月：フォトレジストの量産開始



ArFの売上高



(注) 11/3上期の売上高を100として指数化。

ArFの事業成長力強化

W/Wベースシェア 30%超

TSV装置の事業強化

事業環境

- 三次元実装市場の立ち上がり遅延。
 - ✓ 2.5D：試作ラインとして本格投資の検討、2～3年後の本格的な実用化を期待。
 - ✓ 3D構造：3次元LSIの低コスト化が課題、検証評価が主体。



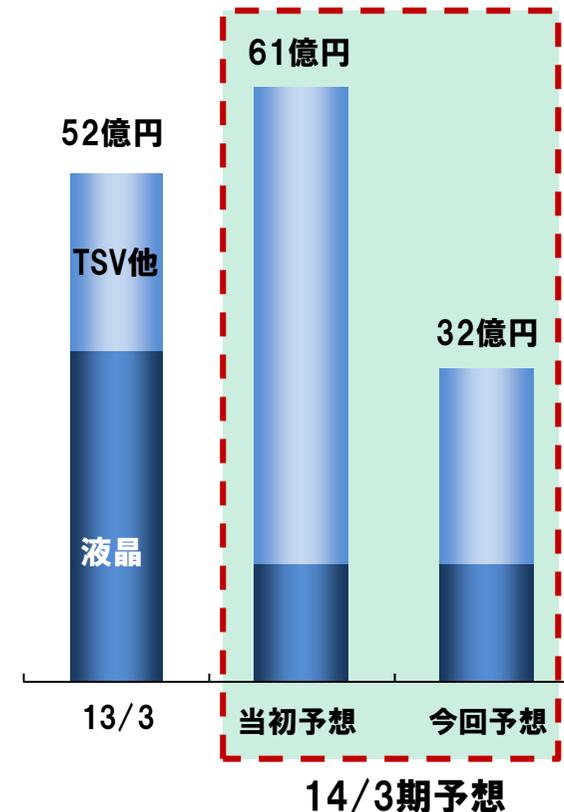
取組み・実績等

- 2.5D試作ラインの技術的検証において良好な評価を獲得。
- 受注実績伸ばせず、受注計画の進捗に遅れ。

今後の注目

- 2.5Dの量産化の動き、3D構造への発展。
- アプリケーション市場の更なる革新・進化
 - ✓ ネットワーク、ゲーム、サーバー、モバイル

装置事業の売上高



先端実装プロセス関連材料

事業環境

- 半導体パッケージの小型化、薄型化ニーズは強く、同関連材料の需要も増大基調。
 - ✓ スマホ、タブレットPCの市場成長
 - ✓ スマホ、タブレットPCの開発競争の激化



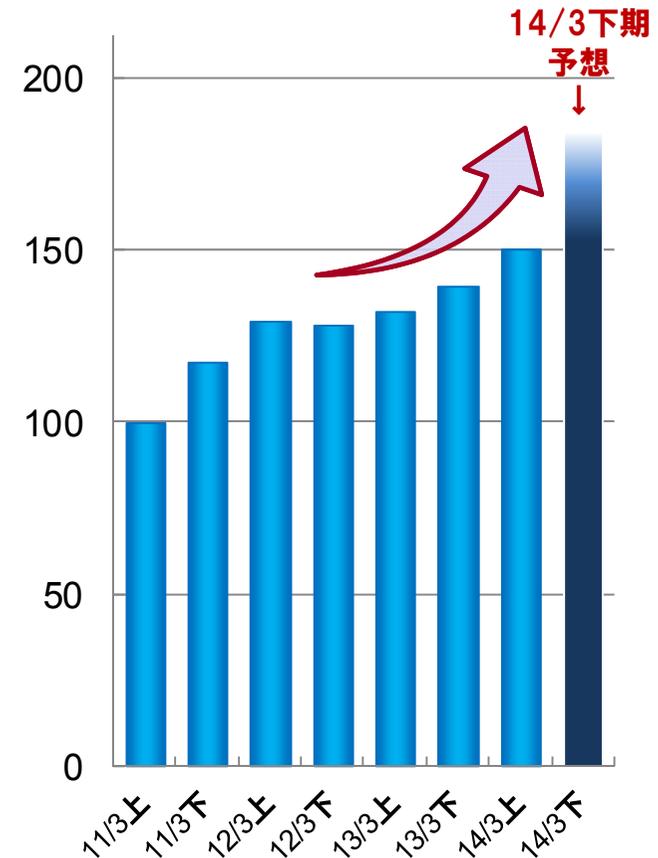
取組み・実績等

- 大手後工程受託メーカー、電子部品メーカーの先端パッケージ向け実装材料の採用獲得。
- 2.5D、3D構造 高密度実装工程向け感光性材料の採用獲得。

今後の注目

- 当該先端パッケージの量産時期、生産規模。
- 2.5Dの量産化、3D構造の試作から量産への移行。
- 新たなパッケージ／実装技術の開発。

高密度実装材料の売上高



(注) 11/3上期の売上高を100として指数化。

新規材料の開発・上市

オプト
エレクトロニクス

再生可能
エネルギー

注力推進中のテーマ

マイクロ
二次電池

ライフ
サイエンス

リチウムイオン
電池関連材料

太陽電池材料

FPD材料

太陽熱発電
関連材料

2015中期計画期間中の売上計上開始を目指す

<http://www.tok.co.jp/>

(ご注意)

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。